

电子行业周报（7.22-7.28）

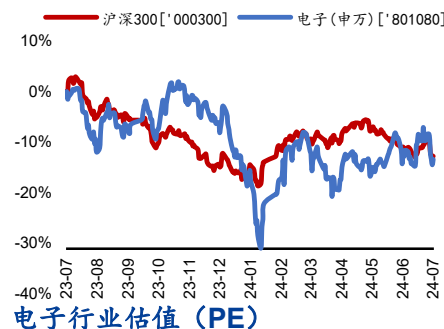
关注行业景气复苏及智能化创新

投资要点：

- 关注行业景气复苏。**半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康。IC设计和半导体经销商的库存周转在23年Q1度达到高点后，连续三个季度下降，并在23年Q4触底。24年Q1末平均周转天数较去年同期减少了69.78天，行业去库存进展顺利。而随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。据半导体行业协会数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%。2024年每个月，全球半导体市场都实现了同比增长，且5月份的销售增长率创下了2022年4月以来的最大增幅，行业复苏势头强劲。当前，据科创板日报报道，24Q2以来，在AI算力及多家大厂急单的推动下，出现量大且覆盖面广的产品需求，致使头部晶圆厂已出现产能紧张的状况。而稼动率的提升将有望改善相关固定资产的经济效率，那么重资产的晶圆制造、晶圆封测等环节盈利弹性值得期待，与此同时，半导体材料出货量也有望随着稼动率的提升而从中获益。此外，库存水位合理且具备价格弹性的存储、SoC、模拟IC等环节也有望迎来新一轮周期向上。
- 关注智能化创新。**边缘计算落地于物联网终端设备，形成了百花齐放的AIoT。一方面，AIoT设备具有提供综合解决方案的能力，分析能力从终端转移到云端，并且能够提供差异化和具有针对性的结果，有望解决IoT面临的被动式交互导致的分析沟通能力有限等问题。另一方面，传统AI往往局限在“学习-决策”阶段，而多样化IoT设备带来的多样化数据类型可以丰富AI感知能力，助力AI应用“感知-学习-决策-执行”商业闭环的落地。AI与IoT技术的融合，将有助于解决AI规模化应用面临的重重挑战，打通AI应用的最后一公里。IDC预测，到2024年，近20%的IoT系统将支持人工智能。随着AIoT渗透率提升，其对应芯片、模组、边缘控制器等等产业链环节也将迎来机遇。
- 投资建议：**半导体景气复苏方向，建议关注中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等晶圆制造及封测环节，此外建议关注SoC芯片全志科技、瑞芯微、北京君正、晶晨股份等。AIOT方向，建议关注乐鑫科技、全志科技、瑞芯微、北京君正、博硕科技、领益智造、博通集成等。
- 风险提示：**技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师 杨钟
执业证书编号：S0210522110003
邮箱：yz3979@hfzq.com.cn

联系人 詹小璿
邮箱：zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 《边缘 AI 迈入深水区，AIoT 前景可期》——2024.07.14
- 《受惠于服务器/HBM 需求，存储延续涨价趋势》——2024.07.07
- 《关注晶圆厂稼动率提升及 IC 涨价》——2024.06.17

正文目录

一、	本周市场表现.....	3
1.1	电子板块本周表现.....	3
1.2	SW 电子个股本周表现	3
1.3	电子板块估值分析.....	4
二、	行业动态跟踪.....	5
2.1	半导体板块.....	5
2.2	AI 板块.....	5
2.3	消费电子板块.....	9
2.4	汽车电子板块.....	9
2.5	面板板块.....	11
三、	公司动态跟踪.....	13
四、	风险提示.....	14

图表目录

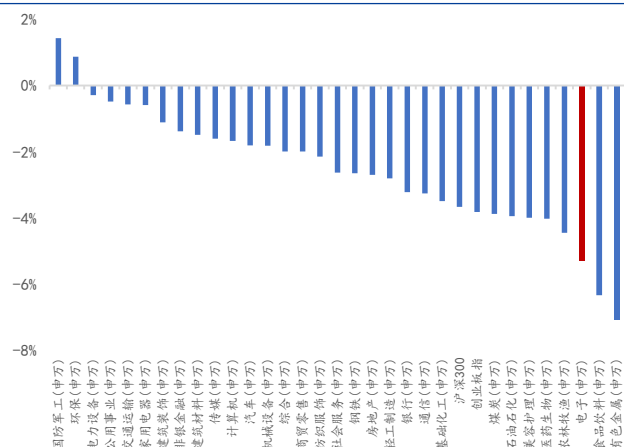
图表 1: SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%)	3
图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%)	4
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%)	4
图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%)	4
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)	5
图表 9: 过去一周股东增减持更新	13
图表 10: 过去一周股权激励一览.....	14

一、 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

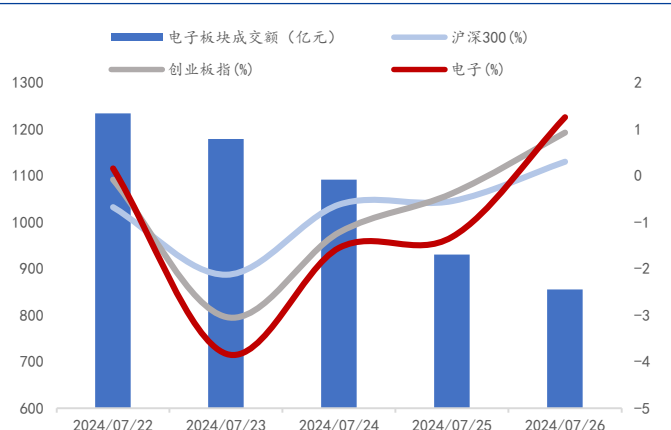
大盘表现上，本周（0722-0728）创业板指数下跌 3.82%，沪深 300 指数下降 3.67%。本周电子行业指数下跌 5.29%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 29 位，本周国防军工、环保、电力设备板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



数据来源：Wind，华福证券研究所

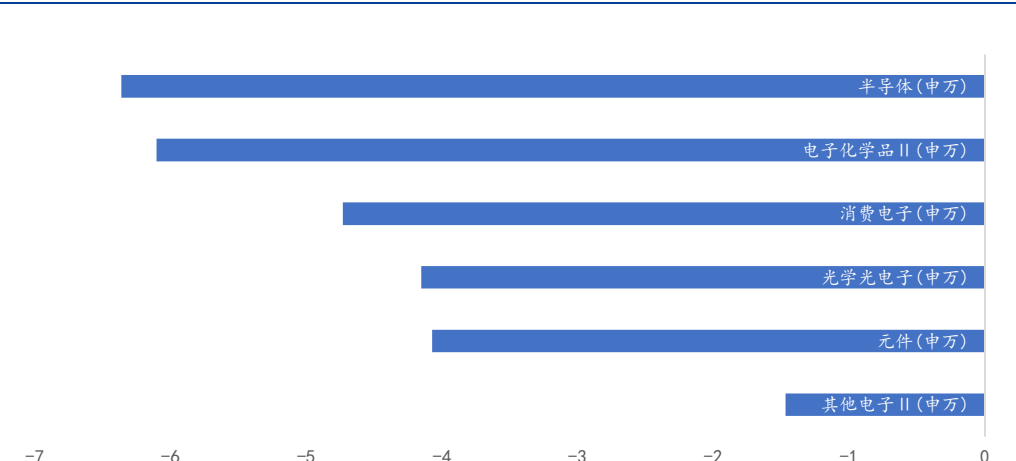
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



数据来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块均有一定程度的下滑，具体来看，其他电子板块跌幅最小，周涨跌幅为-1.47%；半导体板块跌幅最大，周涨跌幅为-6.36%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%）

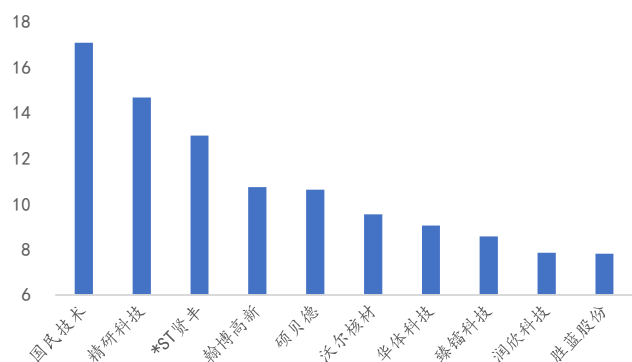


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

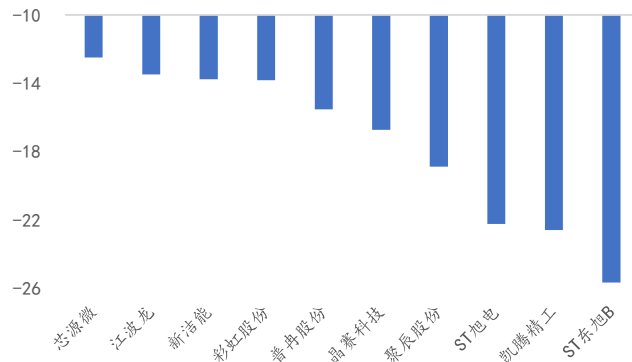
从个股维度来看，SW 电子板块中，国民技术（17.08%）、精研科技（14.67%）等位列涨幅前列；ST 东旭 B（-25.64%）、凯腾精工（-22.57%）等位列跌幅前列。

图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

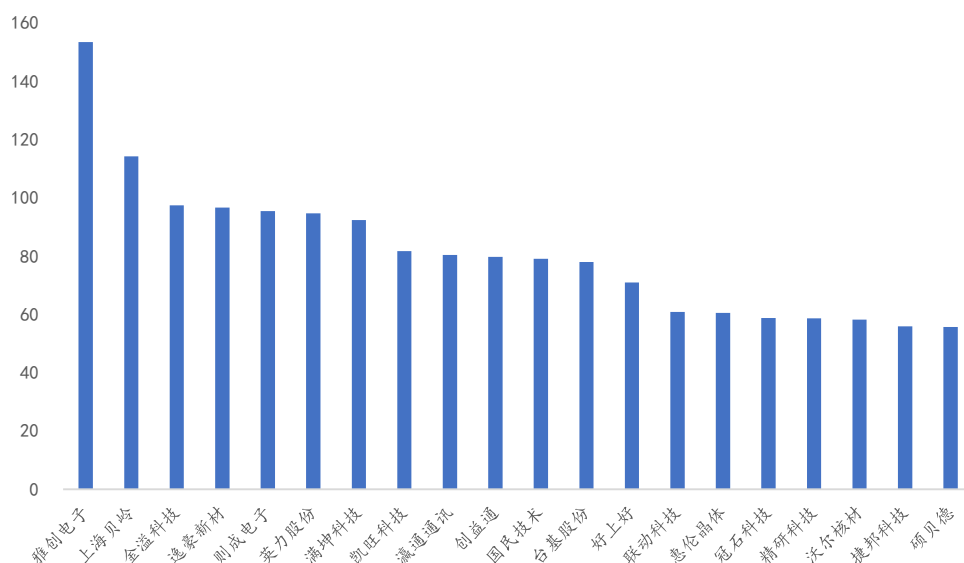
图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%）



数据来源：Wind，华福证券研究所

从换手率来看,本周电子行业个股换手率最高的是雅创电子,换手率为 153.29%。其余换手率较高的还有上海贝岭（114.07%）、金溢科技（97.28%）和逸豪新材（96.55%）。

图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%）

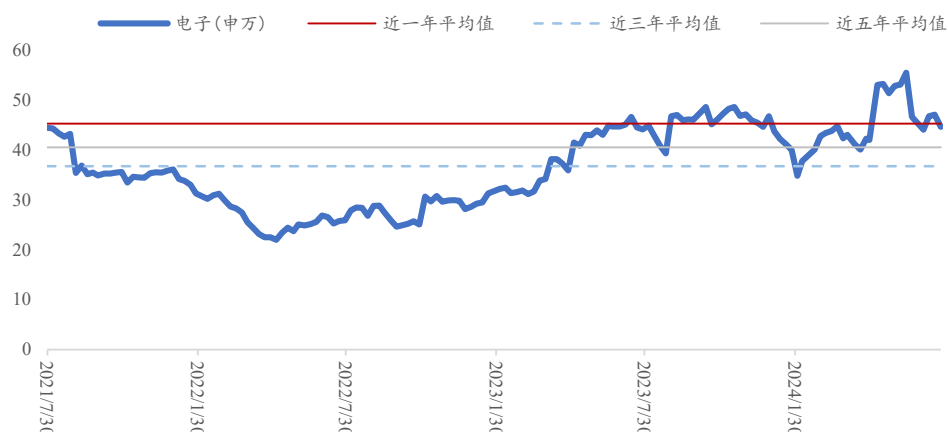


数据来源：Wind，华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看,整体电子行业估值已回调至近一年均值水平以下,同时高于近三年、五年平均值水平。本周 PE（TTM）为 44.65 倍,较上周有所回调。

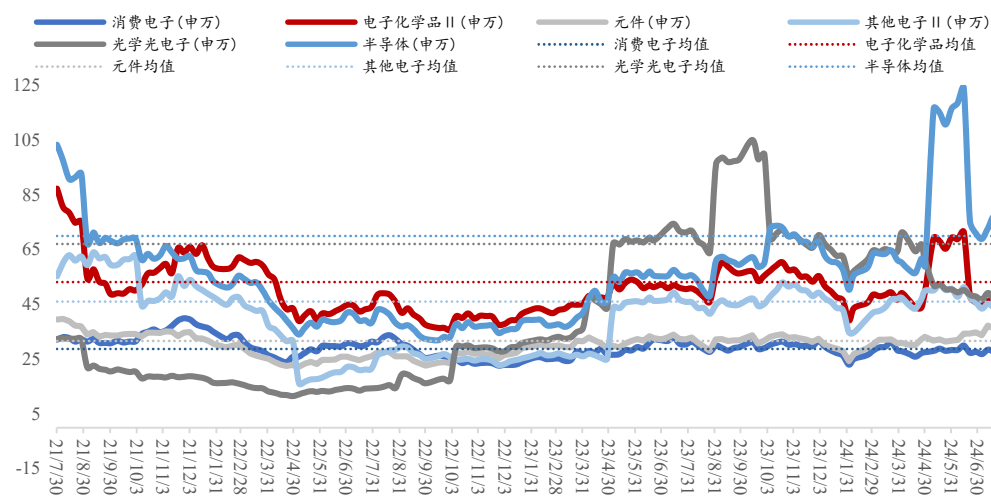
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 26.2、43.98、34.67、43.29、44.99 和 72.32, 本周电子细分板块估值均有一定程度回落。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



数据来源: Wind, 华福证券研究所

二、行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 机构: 受价格上涨和 HBM、QLC 推动, 2025 年存储器产业营收将创新高

研究机构 TrendForce 集邦咨询发布的最新存储器产业分析报告显示, 受惠于位元需求增长、供需结构改善拉升价格, 加上 HBM (高带宽存储器) 等高附加价值产品

崛起，预估 2024 年 DRAM 内存产业营收年同比增长 75%，NAND Flash 闪存产业营收年同比增长 77%。而 2025 年产业营收将创历史新高，其中 DRAM 内存年增约 51%、NAND 闪存年增长 29%，并且推动资本支出回温、带动上游原料需求，不过存储器买方成本压力将随之上升。

TrendForce 集邦咨询估计，DRAM 均价在 2024 年增加 53%、2025 年增加 35% 的条件下，进一步推升 2024 年 DRAM 营收增长 75% 达 907 亿美元，2025 年营收增长 51% 达 1365 亿美元。该机构表示，驱动 DRAM 营收的因素包括 HBM 崛起、一般型 DRAM 产品世代演进、原厂资本支出限缩供给和服务器需求复苏。相较一般型 DRAM，HBM 除拉升位元需求，也拉高产业平均价格。预估 2024 年 HBM 将贡献 DRAM 位元出货量 5%、营收 20%。此外，DDR5 和 LPDDR5/5X 等高附加价值产品的渗透同样有助提高平均价格。据估计，DDR5 将分别贡献 2024、2025 年服务器 DRAM 位元出货量 40%、60%~65%，LPDDR5/5X 会贡献 2024 年、2025 年移动平台 DRAM 位元出货量 50%、60%。

TrendForce 集邦咨询表示，存储器产业营收创纪录背景下，原厂将有足够现金流加速投资。预估 2025 年 DRAM、NAND 闪存产业资本支出分别年增 25%、10%，且有机会上调。此外，存储器生产规模提升将带动对硅晶圆、化学品等上游原料需求，不过存储器价格上涨将增加电子产品成本，ODM（原始设计制造商）和 OEM（原始设备制造商）较难完全将成本反映在零售价上，利润将被压缩，终端销量也可能受到影响，导致需求下滑。

2) 传三星 HBM3 获英伟达认证，将用于中国版 H20 芯片

7 月 24 日，有消息称，三星电子第四代高带宽存储器 HBM3 已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达应对美国政策而专门为中国市场设计的 AI 芯片 H20。

消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他 AI 处理器中使用三星的 HBM3，又或者 HBM3 是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代 HBM3E 芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。

对此消息，英伟达和三星拒绝发表评论。

据两位消息人士称，三星最早可能在 8 月份开始为英伟达的 H20 处理器供应 HBM3。H20 是英伟达为中国市场量身打造的三款 GPU 中最先进的一款，其运算能力相较于 H100 有显著上限。H20 在中国销售市场上起初表现不佳，但目前正快速增长中。

3) 台积电中国大陆超急订单激增，客户甘愿支付 40% 溢价

据业内消息人士透露，台积电收到了中国大陆客户超级急件（SHR）订单量的增加，客户愿意为此支付 40% 的溢价。消息人士称，中国大陆 SHR 订单的增加也助力台积电第二季度出色的毛利率和积极的第三季度前景。



消息人士指出，中国大陆芯片制造商加快向台积电下单的步伐，以应对即将到来的美国总统大选给中美关系带来的不确定性。消息人士称，基于这一假设，除了美国禁令急剧收紧和汇率等因素外，台积电第三季度和全年的营收和毛利率可能会超出预期。2024 年第二季度，台积电的毛利率和营业利润率均超过之前的预测。

台积电第二季度毛利率达到 53.2%，超出 51%~53% 的目标。此外，台积电还将第三季度毛利率指引上调至最高 55.5%。这些发展都是出乎意料的。台积电将其第二季度有利的业绩完全归功于有效的成本管理和生产能力的更高利用率。

台积电观察到客户对高端手机和人工智能(AI)芯片的需求大幅增加。晶圆厂 3nm 和 5nm 工厂的利用率将在 2024 年下半年继续提高。因此，全年业绩预测已上调至更高区间，2024 年有望实现大幅增长。

4) 消息称台积电德国厂年底动工，2027 年量产

据半导体设备制造商消息人士透露，台积电预计将于 2024 年底左右在德国破土动工建设新晶圆厂，并于 2027 年底开始量产。消息人士称，台积电在过去一年多的时间里一直在为德累斯顿晶圆厂项目招募建设者和供应商，包括 Marketech International 在内的中国台湾供应商人员已多次前往德累斯顿为该项目做准备。

消息人士称，按照目前的计划，该晶圆厂将于 2027 年第四季度投入量产，并在 2028 年逐步将产量提高到每月 40000 片晶圆的满负荷产能。

台积电德国 12 英寸晶圆厂将专注于 28nm/22nm 和 16nm/12nm 工艺，针对汽车和工业应用市场，但其管理难度将不亚于台积电位于美国亚利桑那州的晶圆厂，后者将采用最先进的工艺生产芯片。消息人士称，预计台积电德累斯顿晶圆厂利润微薄，风险较高。

预计美国和德国的生产成本将远高于中国台湾。台积电将不得不提高其德国工厂的制造报价，但并不能保证它一定能盈利。

5) 日月光二度调高今年资本支出，明年先进封装营收会再倍增

日月光投控(3711)搭上 AI 热潮带来先进封装强劲需求，营运长吴田玉昨(25)日表示，原订今年先进封装营收增加 2.5 亿美元(逾新台币 82 亿元)的目标将可超标，为满足订单需求，二度调高今年资本支出，看好本季业绩续扬，明年先进封装营收会再倍增。

吴田玉并未透露今年日月光投控资本支出确切金额，仅表示，今年资本支出主要用于先进封装与先进测试，其中 53% 用于封装、38% 用于测试、1% 为材料、8% 为 EMS。

法人指出，日月光投控去年资本支出约 15 亿美元(约新台币 492 亿元)，原预期今年约 21 亿美元(约新台币 688 亿元)，年增四至五成，4 月上调至年增五成以上，此次二度上调后，全年资本支出可望达 30 亿美元(约新台币 984 亿元)，较去

年倍增，凸显客户需求远超乎预期。

日月光投控财务长董宏思补充，下半年是传统旺季，但市场复苏速度低于公司预期，毛利率也会略受压抑，预估未来会逐步回升至目标区间，不过在先进封装业务方面，感受到需求强劲成长，也积极扩产追赶客户需求。

展望本季营运，吴田玉指出，根据当前业务评估及汇率假设，若以新台币计价，封测事业营收将季增高个位数百分比、毛利率介于 23%到 23.5%之间；电子代工服务（EMS）方面，若以新台币计价，营收将季增 15%至 20%，营益率略高于去年第 4 季的 3.5%。

6) 晶圆制造设备，2024 年将增长 1.3%

得益于先进逻辑以及 NAND 和 DRAM 存储器的 WFE 支出增加，2024 年全年晶圆制造设备的收入同比增长 1.3%，达 1081 亿美元。

市场研究机构 Yole 报告称，预计 2024 年全年晶圆制造设备的收入同比增长 1.3%，达 1081 亿美元。这得益于先进逻辑以及 NAND 和 DRAM 存储器的 WFE 支出增加，同时旧工艺节点投资强劲。因全球晶圆厂利用率增加，预计 2024 年服务和支持收入将增长 6%，达 235 亿美元。长期看，预计 2024 -2029 年 WFE 收入年复合增长率（CAGR）为 4.3%，2029 年将达 1337 亿美元，服务和支持收入将达 276 亿美元，年复合增长率为 3.3%。

随着全球科技产业的飞速发展，半导体行业作为其中的核心驱动力，其市场动态一直备受关注。在 2024 年第一季度，全球前五大晶圆设备制造商的收入同比下降了 9%，这一变化主要源于客户对尖端半导体的投资延迟。在半导体行业中，尖端技术一直是推动市场增长的重要力量，然而由于各种因素，包括技术瓶颈、市场饱和以及全球经济形势的不确定性，客户对尖端半导体的投资步伐放缓，导致设备制造商的收入受到影响。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示：“随着今年半导体制造设备总销售额的增长，预计 2025 年将实现约 17%的强劲增长。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。”

在中国大陆市场，晶圆设备制造商的规模增长尤为显著。2023 年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的 342 亿美元，增长 8%，全球占比达到 30.3%。预计 2024 年中国大陆半导体设备市场规模将达到 375 亿美元，增长 9.6%。未来 2-3 年零部件产业将迎来高速高质量发展，由点及面逐渐完善，并对设备环节形成全面有效支撑。

据 TechInsights 预测，未来 5 年，中国大陆的半导体产能将增长 40%。

TechInsights 的调查数据显示，中国大陆的硅片总产能预计会从 2018 年的 3.1 亿平方英寸增加到 2024 年的 6.31 亿平方英寸，2029 年将达到 8.75 亿平方英寸，产

值由 2018 年的 110 亿美元增长到了 2023 年的近 300 亿美元。

2.2 AI 板块

1) 我国算力总规模全球第二，超算数量位列全球第一

截止 2023 年，我国共有 14 座国家级超算中心。

中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）本月发布《中国算力中心服务商分析报告（2024 年）》。报告指出，在总体规模方面，截至 2023 年，全国在用算力中心机架总规模已超过 810 万标准机架，算力总规模达到 230EFLOPS，位居全球第二。预计未来五年，中国算力中心服务市场将以 18.9% 的复合增速持续增长，预计 2027 年市场规模达 3075 亿元人民币。

报告中提及，我国算力中心建设规模和数量持续攀升。受益于“新基建”、“东数西算”的发展机遇以及爆发式增长的算力需求，我国算力中心建设规模不断扩大。据中国信通院统计，我国在用机架数量三年复合增长率约 30%，截至 2023 年，算力中心机架规模稳步增长，全国在用算力中心机架总规模超过 810 万标准机架，算力总规模达 230EFLOPS，位居全球第二，算力基础设施建设取得显著成效。

据国际咨询机构 IDC 预计，未来五年，中国算力中心服务市场将以 18.9% 的复合增速持续增长，预计 2027 年市场规模达 3075 亿元人民币。

智能算力超过基础算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。据信通院统计，截至 2023 年 6 月底，我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到 25.4%，超过四分之一，智能算力规模同比增长 45% 比算力规模整体增速高 15 个百分点，且随着 AI 大模型的快速发展智能算力需求呈现爆发式增长态势，未来智能算力将迎来更加快速的增长，预计到 2025 年智能算力占比达到 35%。

我国超算中心市场规模全球领先。我国高度重视科技创新，在超算技术方面不断取得突破，自主研发的超级计算机多次获得世界超算 500 强排名的前列位置。根据第 56 期全球超级计算机 TOP500 榜单数据，中国部署的超级计算机数量继续位列全球第一，达到 226 台，占总体份额超过 45%。截止 2023 年，我国共有 14 座国家级超算中心，分别位于天津、深圳、长沙、济南、广州、无锡、郑州、昆山、成都西安、太原、重庆和乌镇。

2.3 消费电子板块

1) 三星新款折叠屏手机 Fold6 和 Flip6 预售 91 万部

据媒体报道，三星电子折叠屏手机 Galaxy Z Fold6 和 Flip6 预售量为 91 万部。

三星电子表示，上述两款手机从 7 月 12 日~18 日的预售量共计 91 万部，不及创下最高预售纪录的 Galaxy Z5 系列（102 万部）。

值得关注的是，预购用户中 20~39 岁人群的比重较前作的 43%提升 7 个百分点至 50%。三星方面分析认为，新款重量比前作轻 14 克，厚度 12.1 毫米，携带更方便，这一点获得年轻用户的好评。

Fold6 预售量比 Fold5 提升 10%左右，Fold6 和 Flip6 的预售比例为 4: 6，前款则为 3: 7。各大移动运营商当天起为预购用户提前办理入网手续。

2) 传苹果最快 2026 年推出折叠 iPhone 设计类似三星 Galaxy Z Flip

根据美媒《The Information》周二(23 日)援引知情人士消息报导，苹果最快可能会在 2026 年推出折叠 iPhone，比近期其他媒体爆料的 2027 年推出还更早，据称设计类似三星 Galaxy Z Flip。

关于苹果生产折叠 iPhone 的报导已持续好几年，至少与其竞争对手生产折叠手机的时间一样长。最近有爆料指出，苹果正在考虑两种不同设计的折叠 iPhone，而且要到 2027 年才会推出。然而《Digitimes》先前报导指出，苹果可能已经选择了自己的设计，而且整个时间表可能会加快。根据南韩媒体报导，苹果于 2004 年开始正式研究折叠手机，这也是苹果与三星签署合约的时间。

分析指出，假设苹果产品的开发周期通常为两年，那么爆料预测的折叠 iPhone 推出时间就是在 2026 年。分析也认为，虽然《Digitimes》在供应链消息方面准确，但从未在消息来源获得细节，因此该媒体在根据其讯息得出结论方面稍有失准。然而继《Digitimes》后《The Information》的报导却证实了爆料中的细节。根据后者报导，苹果开发折叠 iPhone 的代号为「v68」，研发时间框架为两年而且维持 iPhone 基本设计。

3) Canalys：二季度中国本土手机厂商首次包揽前五

2024 年第二季度，中国大陆智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长 10%，重回 7000 万台水平。vivo 出货同比增长 15%，重回中国市场榜首，凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉，出货量达 1310 万台，市场份额达 19%。OPPO 凭借 Reno 12 系列新品的发布，以 1130 万台的出货量稳坐第二席位。荣耀发布新品 200 系列，以 1070 万台的出货量排名第三，同比增长 4%。华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓，以 1060 万台的出货量，位居第四。小米通过 SU7 汽车的发布拉动了品牌曝光度，其爆款 K70 系列和旗舰 14 系列继续保持强劲的势头，以 1000 万台的出货量以及 17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降 2%，占据 14%的市场份额。

4) Counterpoint: 2024 年 Q2 中国智能手机销量同比增长 6%，vivo、苹果、华为前三

7 月 26 日消息, 根据 Counterpoint 的手机销量月度数据服务 (Market Pulse), 2024 年第二季度中国智能手机销量同比增长 6%。

618 购物节期间, 在促销折扣的帮助下, 智能手机销量同比增长 6.8%, 也同时提振了第二季度智能手机销量。2024 年第二季度的表现进一步证实了全球最大智能手机市场正在复苏, 并且也预示着 2024 年全球智能手机销售整体前景向好。

报告显示, 2024 年第二季度, vivo 以 18.5% 的份额稳居中国智能手机市场榜首, 其次是苹果 (15.5%) 和华为 (15.4%)。vivo 不仅保持了领先地位, 而且还优化了其产品组合。高端的 X 系列的销售占比比过去几年有所增加。本季度, X 系列新增了主打旗舰影像体验的 X100 Ultra。

与此同时, iPhone 15 Pro 和 Pro Max 在 2024 年第二季度的销量占比约为 50%, 高于去年同期 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的 47%。这反映了中国 iOS 用户对 Pro 机型的强烈偏好, Pro 系列机型有更强处理性能、出色的影像能力以及显示效果。

得益于 Pura 70 系列和 Nova 12 系列的热销, 华为在 2024 年第二季度的销量同比增长 44.5%, 增幅在所有品牌中最高。然而, 华为在当季的市场份额为 15.4%, 仍低于其 2020 年达到的 40% 左右的峰值水平。

2024 年 Q2 中国智能手机市场的表现进一步佐证了该机构此前的预测, 即 2024 年全年中国智能手机市场将实现个位数的同比增长。第三季度, 中国手机品牌厂商会更新其旗舰产品线, 发布包括直板和折叠形态的手机, 这将进一步加剧市场竞争。

2.4 汽车电子板块

1) 比亚迪宋 PLUS 累计销量破百万: 新能源 SUV 市场里程碑

2024 年 7 月 22 日, 比亚迪宣布旗下热门 SUV 车型宋 PLUS 累计销量突破 100 万辆, 成为中国首个达成百万销量的新能源 SUV 品牌。这一里程碑不仅彰显了比亚迪在新能源汽车领域的卓越成就, 也展示了其在中国汽车市场的领导地位。

自 2021 年 3 月宋 PLUS DM-i 上市以来, 这款车迅速成为比亚迪品牌的销量支柱。以其出色的性能、时尚的设计和亲民的价格, 宋 PLUS 在短时间内赢得了市场的青睐, 并成功超越了哈弗 H6 等竞争对手, 成为中国品牌中用时最短达到 80 万辆生产的新能源 SUV。

2.5 面板板块

1) 大屏电视需求增长促进 OLED 市场反弹 LG 显示 2025 年将扭亏为盈

自今年年初以来，大型 OLED 屏幕的需求一直在上升。随着 2024 年巴黎夏季奥运会等特别活动的举办，电视制造商（包括 LG 显示和三星显示）纷纷增加产量，OLED 屏幕的需求增速正在加快。

7 月 23 日，市场研究公司 Omdia 表示，预计今年 OLED 电视面板出货量将达到 705 万台，较 2023 年的 529 万台增长 33%。随着消费者越来越追求更大、更清晰的屏幕，预计到 2030 年，OLED 电视面板的销量将增至近 1000 万台。预计 2025 年，在价格 1500 美元及以上的高端电视市场中，OLED 面板的占比将达到 52.8%，这是 OLED 面板占比首次超过 50%。相比之下，LCD 电视的比例今年将跌破 50%，而 2020 年的峰值比例高达 85.3%。

LG 显示预计扭亏为盈：OLED 电视需求的增长对全球最大 OLED 制造商 LG 显示来说是一个福音。分析师预计，LG 显示今年将实现营业亏损 3500 亿韩元（约合 2.53 亿美元），较 2023 年的 2.5 万亿韩元亏损大幅改善。2025 年，该公司预计将实现 4500 亿韩元的利润，这是自 2021 年以来首次扭亏为盈。市场预计 LG 显示今年将向电视制造商发货 575 万台 OLED 面板，比 2023 年的 423 万台增长 35%。OLED 电视的置换需求在美国等发达国家正在上升，尤其是在欧洲，部分原因是即将开幕的巴黎奥运会。

2) 报告称 2024 上半年全球 AMOLED 手机面板出货量约 4.2 亿片，同比增长 50.1%

7 月 25 日消息，根据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年上半年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 4.2 亿片，较去年同期增长 50.1%；其中第二季度同比增长 55.3%，环比增长 13.1%。

报告称，2024 年上半年全球 AMOLED 智能手机面板需求持续旺盛，一方面得益于全球智能手机市场回暖，另一方面归功于国内 AMOLED 产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。

统计数据显示，2024 年上半年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 4.2 亿片，较去年同期增长 50.1%。其中，柔性 AMOLED 智能手机面板占比 71.0%，同比下滑 8.8 个百分点。

分地区来看，2024 年上半年全球 AMOLED 智能手机面板市场韩国地区份额占比 49.3%，跌破五成；国内厂商出货份额占比 50.7%，同比增加 10.1 个百分点，超越五成。

三、 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本比(%)
603989.SH	艾华集团	2024-07-24	增持	湖南艾华控股有限公司	控股股东		
301045.SZ	天禄科技	2024-07-24	减持	马长建	持股 5%以上股东	600,000.00	0.54
688123.SH	聚辰股份	2024-07-23	减持	聚辰半导体(香港)有限公司	股东	3,180,000.00	2.00
688123.SH	聚辰股份	2024-07-24	减持	聚辰半导体(香港)有限公司	股东	3,180,000.00	2.00
000670.SZ	盈方微	2024-07-24	减持	东方证券股份有限公司	持股 5%以上股东	25,478,620.00	3.00
688037.SH	芯源微	2024-07-23	减持	沈阳先进制造技术产业有限公司	股东	2,004,000.00	1.00
688037.SH	芯源微	2024-07-24	减持	沈阳先进制造技术产业有限公司	股东	2,004,000.00	1.00
688372.SH	伟测科技	2024-07-24	减持	深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东		
688589.SH	力合微	2024-07-24	减持	陈金城	5%以上非第一大股东	900,000.00	0.89
301329.SZ	信音电子	2024-07-23	减持	富拉凯咨询(上海)有限公司	持股 5%以上股东	1,500,000.00	0.88
600745.SH	闻泰科技	2024-07-25	减持	无锡国联集成电路投资中心	持股 5%以上股东	12,428,095.00	1.00
688213.SH	思特威-W	2024-07-26	减持	共青城思智威科技产业投资合伙企业(有限合伙)	股东	2,203,853.00	0.55
688213.SH	思特威-W	2024-07-26	减持	BrizanChinaHoldingsLimited	股东	1,471,347.00	0.37
688213.SH	思特威-W	2024-07-26	减持	ForebrightSmartEyesTechnologyLimited	股东	4,325,000.00	1.08
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	李琼霞	股东	30,497.00	0.02
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	李云	股东	19,036.00	0.02
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	卞尔丽	股东	30,497.00	0.02
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	湛光平	股东	540,000.00	0.43
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	杨绍煦	股东	1,276,895.00	1.02
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	刘辉	股东	48,000.00	0.04
300868.SZ	杰美特	2024-07-23	减持	刘述卫	股东	11,300.00	0.01
688008.SH	澜起科技	2024-07-23	减持	WLT Partners, L. P.	股东	11,500,000.00	1.01
688008.SH	澜起科技	2024-07-23	减持	嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)	股东	650,000.00	0.06
688008.SH	澜起科技	2024-07-23	减持	中国电子投资控股有限公司	股东	5,057,300.00	0.44
688008.SH	澜起科技	2024-07-24	减持	嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)	股东	650,000.00	0.06
688008.SH	澜起科技	2024-07-24	减持	中国电子投资控股有限公司	股东	5,057,300.00	0.44
688008.SH	澜起科技	2024-07-24	减持	WLT Partners, L. P.	股东	11,500,000.00	1.01
603005.SH	晶方科技	2024-07-24	减持	中新苏州工业园区创业投资有限公司	5%以上第一大股东	13,043,400.00	2.00
688106.SH	金宏气体	2024-07-26	减持	师东升	董事, 监事, 高级管理人员	28,600.00	0.01

数据来源：Wind，华福证券研究所

图表 10：过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当 时总股本比例 (%)	期权初 始行权 价格
688603.SH	天承科技	2024-07-23	董事会预案	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	49.38	0.8493	25.79
002134.SZ	天津普林	2024-07-23	实施	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	398.92	1.6226	8.98
301536.SZ	星宸科技	2024-07-25	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市公司提取激励基金买入流通股	177.15	0.4207	18.38

数据来源：Wind，华福证券研究所

四、风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn